

芯联集成电路制造股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”或“公司”）股东绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“日芯锐”）持有公司股份 216,000,000 股，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅芯锐”）持有公司股份 230,400,000 股，日芯锐及硅芯锐（以下合称“员工持股平台”）为一致行动人，合并计算后持有公司 446,400,000 股，占公司总股本的 6.33%。日芯锐前次累计质押股份 170,000,000 股，占员工持股平台所持有公司股份总数的 38.08%，占公司目前总股本的 2.41%。

● 日芯锐本次补充质押股份 20,000,000 股，本次质押后日芯锐累计质押股份数 190,000,000 股，占员工持股平台所持有公司股份总数的 42.56%，占公司目前总股本的 2.69%。

一、本次股份补充质押基本情况

公司近日接到股东日芯锐通知，获悉其所持有公司的部分股份被补充质押，原股票质押情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份解质押及质押公告》（公告编号：2024-033）。本次日芯锐补充质押具体情况如下：

1、本次部分股份补充质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占员工持股平台所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
日芯锐	否	20,000,000	是	是	2024年9月10日	至质权人申请解除质押为止	交银国际信托有限公司	9.26%	4.48%	0.28%	补充质押
合计	-	20,000,000	-	-	-	-	-	9.26%	4.48%	0.28%	-

2、本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。

3、本次质押是日芯锐以公司 2000 万股公司股票进行补充质押，原股票质押情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份解质押及质押公告》（公告编号：2024-033）。

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，日芯锐及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
日芯锐	216,000,000	3.06%	170,000,000	190,000,000	87.96%	2.69%	190,000,000	0	26,000,000	0
硅芯锐	230,400,000	3.27%	0	0	0	0	0	0	230,400,000	0
合计	446,400,000	6.33%	170,000,000	190,000,000	42.56%	2.69%	190,000,000	0	256,400,000	0

注：以上所有表格中的比例以四舍五入的方式保留两位小数，数据尾差为数据四舍五入相加所致。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年9月12日